

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

隆扬电子（昆山）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称	华泰证券 曹艺矾、张丽英 个人投资者 裴影、韩高茂、顾群、赵成亮、施宇迪、朱志明、李勇鑫 西部证券 朱北岑 国寿安保基金 祝淼 华福证券 陈瑞标、邓伟 华安基金 章昕乔 华泰证券 汤仕翥、赵思彤 博时基金 胡康、赵奕成、王赫、金耀、何海怡、柏正奇 禾永投资 杨正陶、张文乾 (以上排名不分先后)
时间	2026年5月22日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 金卫勤 董事长特助 仲汉尧 证券事务代表 施翌

主要内容介绍	<p>第一部分：公司介绍</p> <p>上市公司介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、发展战略等。</p> <p>第二部分：上市公司解答提问，主要如下：</p> <p>董事会秘书同与会人员进行了问答交流，本次交流主要内容如下：</p> <p>Q1、公司 HVLP5 铜箔目前和客户的验证情况如何？推进如何了？</p> <p>公司的 HVLP5 铜箔目前有配合客户交付部分样品订单，尚未有批量化订单，产品尚在验证之中。</p> <p>Q2、和竞争对手的差异主要在哪里？</p> <p>公司铜箔产品和竞争对手的差异主要是选择不同工艺路线。</p> <p>Q3、公司为什么直接从五代开始做？1-4 代是否有参与？</p> <p>公司目前暂无参与 hvlp1-4 代产品的生产和制作。因本公司采用的工艺路线选择较传统铜箔厂的工艺路线选择不同，磁控溅射技术在做薄和做平坦的方面有较明显的优势，但相应的生产速率较慢。面对高频高速信号传输所需的低表面粗糙度的要求下，公司产品有相应的竞争优势。</p> <p>Q4、公司未来会在哪里建设铜箔工厂？在湖北是否有工厂？</p> <p>公司第一个铜箔细胞工厂在淮安建成，未来主要铜箔生产基地主要安排在江苏淮安。公司在湖北没有铜箔细胞工厂。</p> <p>Q5、请问公司 EMI 材料有哪些应用？有哪些优势？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司主营业务产品 EMI 材料主要应用于笔记本电脑、平板电脑等消费电子领域，及应用中控、雷达等汽车电子领域；可以解决电子产品电磁干扰问题，实现电磁兼容的效果。公司从 EMI 原材料制备到精密模切加工，进行产业垂直整合。</p>
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。

